(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



- I COURT ENCOURT HE CONTRE BETTE LEVEL ELEVE EN LEVEL EN LEVEL EN LEVEL EN LEVEL EN LEVEL ELEVEL ELEVEL ELEVE

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/084830 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B08B 7/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/001301

(22) Internationales Anmeldedatum:

9. Februar 2005 (09.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 04004892.8

2. März 2004 (02.03.2004) E

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

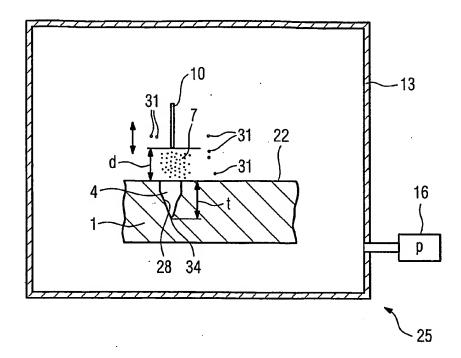
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KRÜGER, Ursus

[DE/DE]; Krampnitzer Weg 11, 14089 Berlin (DE). RE-ICHE, Ralph [DE/DE]; Bulgenbachweg 15, 13465 Berlin (DE). STEINBACH, Jan [DE/DE]; Buchstrasse 8, 13353 Berlin (DE).

- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR PLASMA CLEANING OF A COMPONENT
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR PLASMAREINIGUNG EINES BAUTEILS



(57) Abstract: Cracks are conventionally difficult to clean which often leads to damage to other regions of the component for cleaning. According to the invention, a plasma cleaning method is used, whereby a pressure (p) and/or a separation (d) of an electrode (10) to the component (1) are varied, in order to achieve a plasma cleaning in the crack (4).

WO 2005/084830 A1



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.